

株式会社エンプラス

(証券コード:6961)



よりよき明日を目指して

平成26年3月期 (第53期) 中間報告書
平成25年4月1日から平成25年9月30日まで

enplas

enplas

株式会社エンプラス

Contents

- 01. 企業理念
- 02. 株主の皆様へ
- 04. 連結業績の推移
- 05. 事業別概況
- 07. 特集 オプト事業
- 08. 連結財務の状況
- 09. 会社概要／株式情報
- 10. 株主メモ
- 11. 拠点・グループ会社



わが社の使命

信頼の絆をもとに、あらゆる変化に対応する強靱な経営基盤を堅持し、

1. お客さまに感謝される製品とサービスを提供します。
2. 能力と成果を公正に評価し、社員の生きがいを育みます。
3. 株主の皆さまの期待に応え、企業価値の向上を目指します。

これらの実践を通して豊かな社会の発展に貢献します。

事業領域

エンジニアリングプラスチックで培った先進技術をもとに、さらに最先端技術を追求し、創造的価値を世界市場に提供します。

経営姿勢

1. 卓越した技術と信頼される製品により、競争力と成長力を追求します。
2. 健全な財務体質により着実な発展を図ります。
3. 全ての企業活動において確かな品質に責任を持ちます。

行動指針

1. 創造的な目標を掲げ、情熱を持って挑戦します。
2. 感謝の心と学ぶ姿勢を大切にします。
3. 公私を明確にし、公明正大に行動します。

株主の皆様へ

当社は、創業以来培ってきたエンジニアリングプラスチック総合技術のさらなる先進化と活用により、常に高精度、高機能、高品質を追求し、お客様に感謝されるより良い製品とサービスの提供を通して社会の発展に貢献してまいります。



代表取締役社長 横田大輔

Q 上期の経営実績についてお話しください。

当第2四半期連結累計期間（平成25年4月1日～平成25年9月30日）における世界経済は、欧州景気の低迷は一服し、米国経済にも引き続き改善が見られたものの、中国を含む新興国経済の成長鈍化が顕在化しました。日本経済は、政府、日銀の緊急経済対策のプラス効果が实体经济に徐々に波及し、景気は緩やかな回復基調を継続しました。当社はこのような環境下で、収益力のさらなる向上を実現するために、高付加価値製品や新技術の開発、グローバルでの販拓活動、および高品質の製品を安定的に供給できる生産体制の強化に注力してまいりました。この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は20,154百万円（前年同期比61.4%増）となりました。損益につきましては、営業利益は6,498百万円（前年同期比208.7%増）、経常利益は6,743百万円（前年同期比224.0%増）となりました。当期純利益は5,227百万円（前年同期比223.3%増）となりました。

Q 事業環境および上期に実施した施策についてお話しください。

当社のコア事業であるエンプラ事業関連の自動車部品業界は、米国における自動車の生産・販売台数が急回復を遂げ、これに伴い米国での当社の収益力が向上しました。

オプト関連事業におきましては、LEDを光源とする液晶テレビにおいて光源直下型タイプへの切り替えが加速し、当社の光拡散レンズであるLE-Capの販売が大幅に増加しました。急激な受注の増加に対し、当社は製品設計、金型製作、製品量産から品質保証に至るまで当社の総合力を結集し、安定的に、高品質な製品を、遅滞なく供給することを実現しました。また、今後様々な製品のLED化が加速し、今後は当社製品の横展開が期待される分野の拡大が見込まれます。

半導体市場は、スマートフォンやタブレット用途の増加により好調に推移いたしました。当社のバーンインソケット、テストソケットも車載、PC用途向けを中心に売上、営業利益とも好調に推移し、前年同期比を上回る結果となりました。

Q 下期施策についてお話しください。

下期におきましては、今期の経営基本方針に掲げております「グローバル経営基盤の強化」のために、世界のあらゆる所で、あらゆるソリューションをスピーディーに展開できる体制を構築していきます。半導体業界においては、グローバル競争が激化する中、顧客である半導体メーカーの量産拠点が集中する東南アジア、中国、台湾の事業上の位置付けがより重要となってきました。このグローバル競争に勝ち抜くため、シンガポールに新会社を設立し、半導体機器事業の本社機能を日本からシンガポールへ移管することを決定いたしました。

今回の半導体機器事業本社のシンガポール移転に合わせ、半導体機器事業のさらなる拡大を目的とし、フィリピンにシンガポール新会社100%出資の現地法人を設立することを決定いたしました。

また、バイオ、光通信分野におきましては有力顧客が集中する米国西海岸に新会社を設立し、新規ビジネスおよび新規顧客の獲得による事業拡大を図るとともに、最先端の技術情報の収集を行い、本社と連携し研究開発機能を強化することを決定いたしました。

Q 利益還元についてお願いします。

当社は、健全・堅実な経営により、強固な財務体質を堅持しております。経営活動の成果は、明確な形で株主の皆様へ還元することを基本方針とし、また安定的配当の考え方も取り入れた上で今期以降の業績予想を勘案し、配当を決定しております。

第53期経営基本方針

- 新製品・新領域への挑戦による成長実現
- 先端技術の追求
- グローバル経営基盤の強化

内部留保しております資金についてですが、中長期的展望に立って生産設備投資や研究開発投資、また情報化投資や新事業創出のためのM&A資金などに振り向けられており、将来においても収益力を向上させることを基本概念として、株主の皆様へ還元できるものと考えております。

なお、当期中間配当につきましては1株当たり30円とさせていただきます。また、当期の期末配当金は1株当たり30円、通期で1株当たり60円を予定しております。

Q 株主の皆様へ一言お願いします。

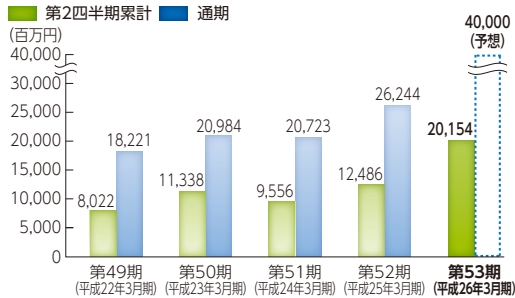
当社は、「お客様に喜んでいただく」、「世の中の役に立つ」という理念のもと、付加価値の高い製品を世界のあらゆる市場に提供してまいります。そして新しいものに挑戦する姿勢を常に持ち続け、「プラスチックでこんなものが作れるのか、こんな使い方があったのか」という新しい提案で常に世界に発し続けるするイノベーションカンパニーを目指してまいります。

今後とも、株主の皆様にはより一層のご支援とご鞭撻をたまわります様、よろしくお願い申し上げます。

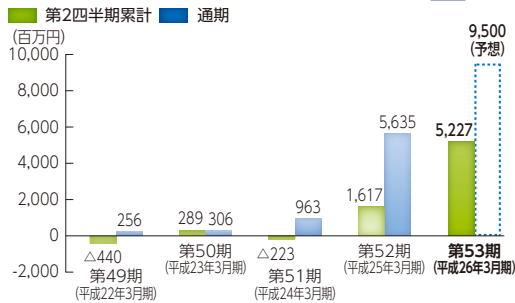
平成25年 12月

連結業績の推移

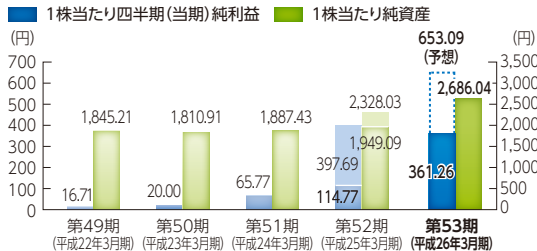
■ 連結売上高 …… 1



■ 連結四半期(当期)純利益(△純損失) …… 3

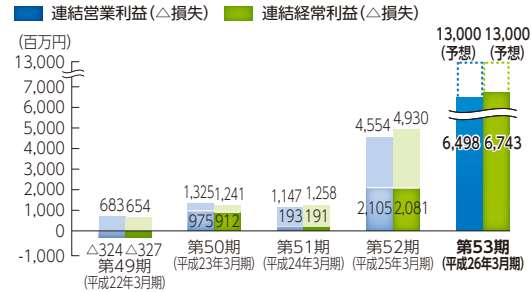


■ 1株当たり四半期(当期)純利益 / 1株当たり純資産

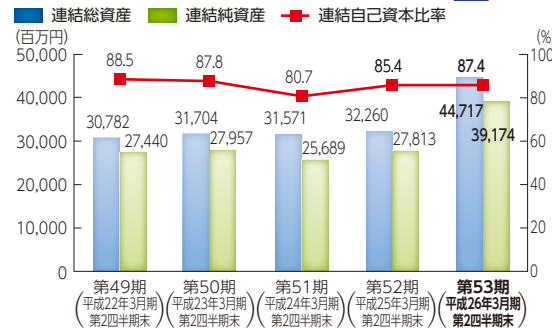


※業績予想や将来の予測等に関する記述は、現時点で入手された情報に基づき合理的と判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性その他の要因が内包されています。従いまして、実際の業績は見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

■ 連結営業利益(△損失) / 連結経常利益(△損失) …… 2



■ 連結総資産 / 連結純資産 / 連結自己資本比率 …… 4



■ 平成26年3月期 通期予想

(単位:百万円)

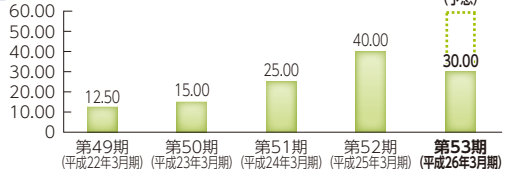
科目	平成25年3月期 通期	平成26年3月期 第2四半期累計	平成26年3月期 通期(予想)
売上高	26,244	20,154	40,000
営業利益	4,544	6,498	13,000
経常利益	4,930	6,743	13,000
四半期(当期)純利益	5,635	5,227	9,500
1株当たり四半期(当期)純利益(円)	397.69	361.26	653.09

株主還元について

**1株当たり
配当金60.00円**

当社では、経営活動の成果を明確な形で株主の皆様へ還元することを基本方針とし、また安定的配当の考え方も取り入れ、今期以降の業績予想を勘案して中間配当を含む年間配当を1株当たり60.00円を予定しております。

■ 配当金 (円)



ポイント 1

当第2四半期累計における連結売上高は20,154百万円(前年同期比61.4%増)となりました。

ポイント 2

連結営業利益は6,498百万円(前年同期比208.7%増)、連結経常利益は6,743百万円(前年同期比224.0%増)となりました。

ポイント 3

連結四半期純利益は5,227百万円(前年同期比223.3%増)となりました。

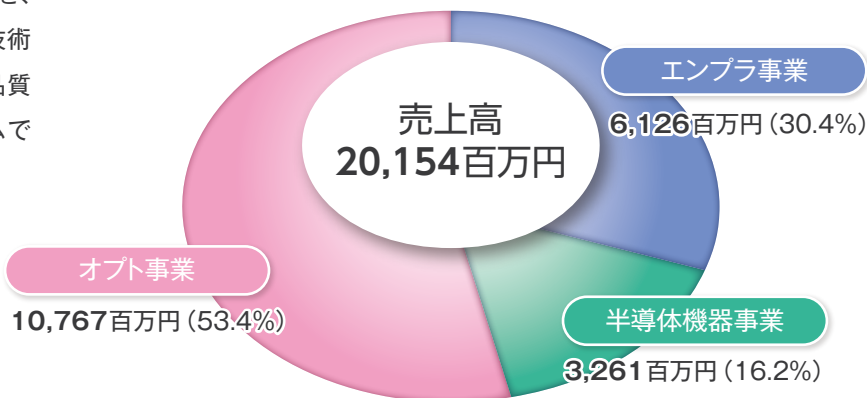
ポイント 4

純資産は39,174百万円となり、その結果、自己資本比率は87.4%となり、前連結会計年度末比で0.8%増加しております。

事業別概況

事業セグメント別売上高構成比 平成26年3月期第2四半期累計(平成25年4月1日から平成25年9月30日)

エンブラスの各事業は、先進のオプティクスやエレクトロニクス技術を、基盤テクノロジーであるエンブラ技術に融合し、設計から量産、そして品質保証まで含めた一貫体制システムで確かな品質を実現しています。

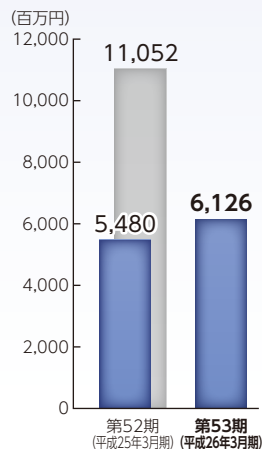


エンブラ事業

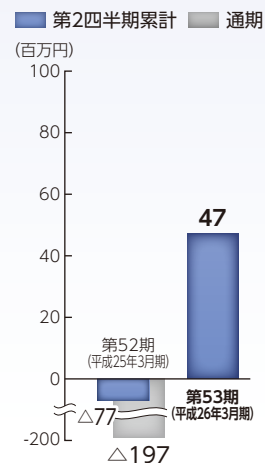
プリンター用部品が低調に推移する一方、自動車用部品は、米国での自動車販売増加の影響を受け好調に推移しました。受注増加により操業度が向上したこともあり、当第2四半期累計の連結売上高は6,126百万円(前年同期比11.8%増)、セグメント営業利益は、47百万円(前年同期は77百万円のセグメント営業損失)となりました。



■ 売上高



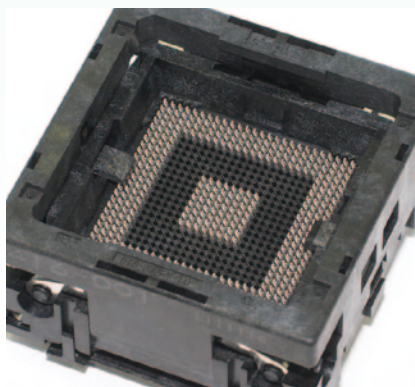
■ 営業利益



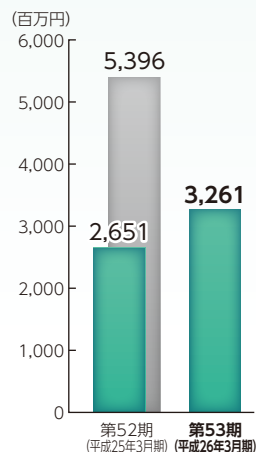
半導体機器事業

車載、CPU向けバーンインソケットが引き続き好調に推移しました。継続的な海外調達拡大と円安効果による原価低減

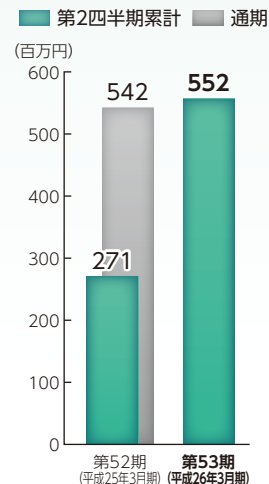
も加わり、当第2四半期累計の連結売上高は3,261百万円（前年同期比23.0%増）、セグメント営業利益は552百万円（前年同期比103.8%増）となりました。



■ 売上高



■ 営業利益



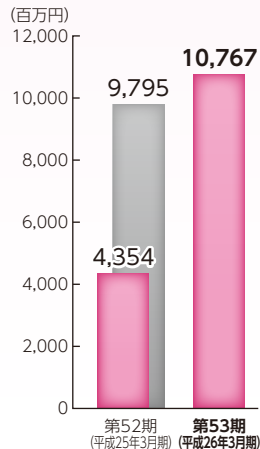
オプト事業

主力のLED用拡散レンズは、引き続き、LED光源液晶テレビの中でもコストメリットのある光源直下型タイプの採用が進んだことにより、当社レンズの販売も増加いたしました。この結果、当第2四半期累計の連結売上高は

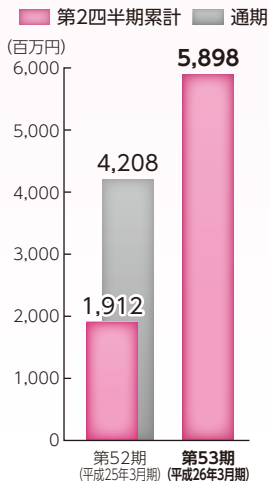
10,767百万円（前年同期比147.3%増）、セグメント営業利益は5,898百万円（前年同期比208.5%増）となりました。



■ 売上高



■ 営業利益



エンプラスの事業の中から、オプト事業、特にLED用拡散レンズについてご紹介します

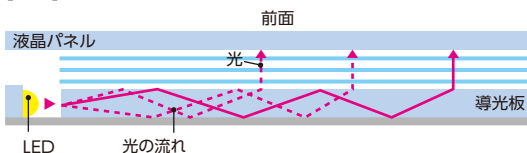
プラスチックの特性を熟知している当社は、蓄積してきたデータと独自の高度な技術力を基盤に、光ピックアップ部品や光通信機器部品など先進的な光学製品を次々と開発してきました。特に、LED用光源拡散レンズはLED液晶テレビの普及とともに今後ますますの市場拡大が期待されます。

LEDテレビ各方式のしくみ

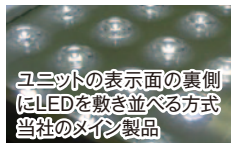
エッジ型タイプ

ユニットの「外周部」にLEDを並べ、光を面に行きわたらせる板（導光板）を使用する方式

[A図] エッジ型LEDバックライトのしくみ (イメージ図)

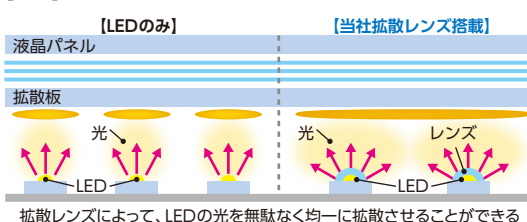


光源直下型タイプ



ユニットの表示面の裏側にLEDを敷き並べる方式
当社のメイン製品

[B図] 直下型LEDバックライトのしくみ (イメージ図)



◆タイプ別強みと弱み

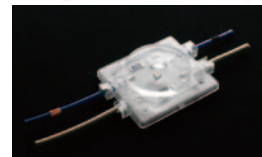
	強み	弱み
エッジ型タイプ	<ul style="list-style-type: none"> ● 器具を薄くできる ● シンプルな構造 	<ul style="list-style-type: none"> ● 導光板の使用により、LEDの光利用効率落ちる ● 導光板により重さが増加 ● 発光面積に限界あり
光源直下型タイプ	<ul style="list-style-type: none"> ● LEDの灯数を自由に設計可能 ● レンズが導光板の役目となるため導光板がなく軽量化 ● LEDの光を無駄なく拡散することでLED数を削減出来る→低コスト実現 ● コントラスト調整に優れている 	<ul style="list-style-type: none"> ● エッジ型よりも厚さがでる

“Light Enhancer Cap”は、直下型方式で使用する場合の弱みを解消します!

“Light Enhancer Cap (拡散レンズ)”モジュール

導光板で培った光束制御技術をベースに、環境に配慮したLEDをより使いやすく効率的に利用できる拡散レンズを開発。消費電力の削減やCO₂の排出量の抑制を実現しました。

Light Enhancer Cap®



- 現在搭載されている製品
テレビ、看板等
- 今後期待できる分野
照明、LEDを多数使用する製品群



液晶テレビ市場の動向

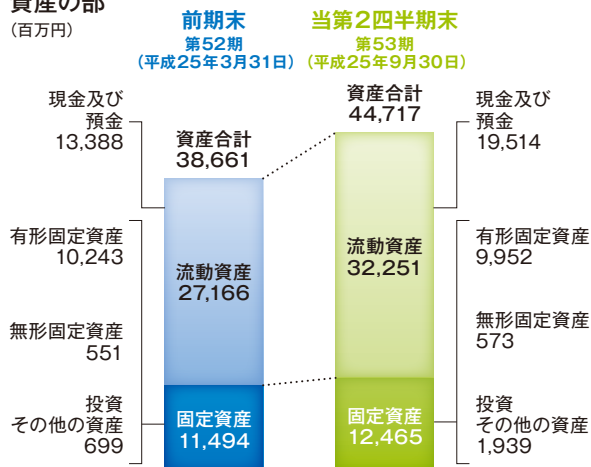
- 2013年以降世界テレビ出荷数は年間プラス成長予測
- CRTテレビ需要が減少し、代替としてLEDテレビ需要が急増
- コストメリットのある光源直下型タイプのシェアの増加

連結財務の状況

■ 連結貸借対照表の概要

資産の部

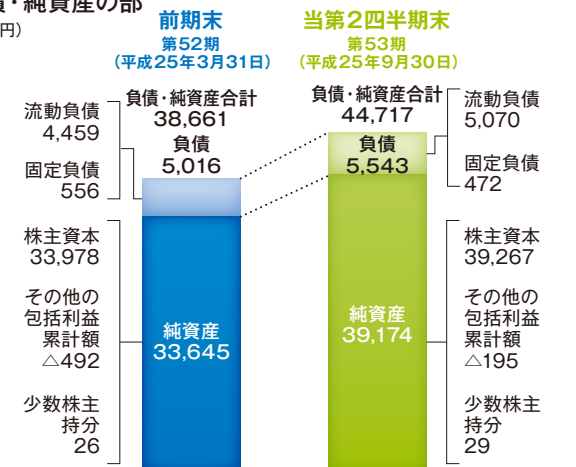
(百万円)



資産合計増加の主な変動要因は、現金及び預金で6,125百万円、有価証券で300百万円、投資その他の資産で1,240百万円増加したことによるものです。

負債・純資産の部

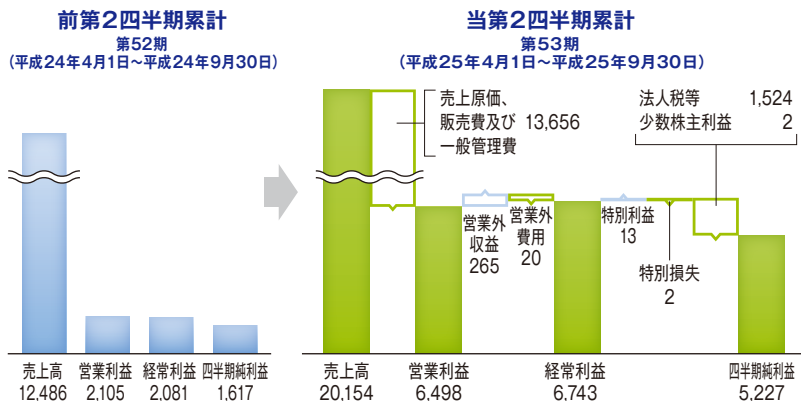
(百万円)



純資産は39,174百万円となり、前連結会計年度末比5,529百万円増加の主な変動要因は、利益剰余金で4,939百万円、為替換算調整勘定で239百万円増加したことなどによるものです。その結果、当第2四半期末の自己資本比率は87.4%となり、前連結会計年度末比で0.8%増加しております。

■ 連結損益計算書の概要

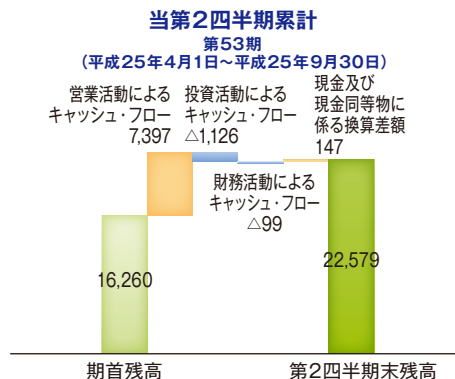
(百万円)



連結売上高は20,154百万円(前年同期比61.4%増)となり、連結営業利益は6,498百万円(前年同期比208.7%増)、連結経常利益は6,743百万円(前年同期比224.0%増)、連結四半期純利益は5,227百万円(前年同期比223.3%増)

■ 連結キャッシュ・フロー計算書の概要

(百万円)



当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は22,579百万円となり、前年同期比で9,581百万円増加しました。

会社概要 / 株式情報 (平成25年9月30日現在)

会社概要

商号 株式会社エンプラス
所在地 埼玉県川口市並木2丁目30番1号
設立 1962年2月21日
資本金 80億8,045万円

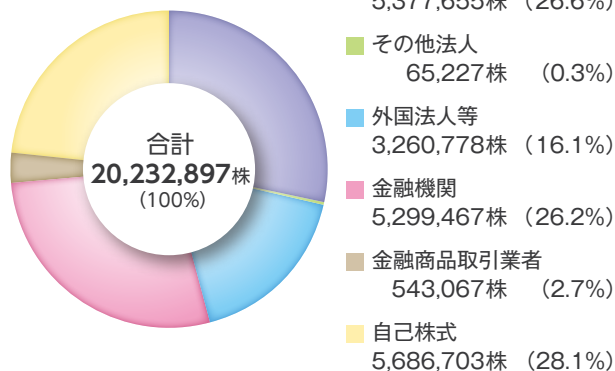
役員

代表取締役社長	横田 大 輔
取締役	酒井 崇
取締役	菅原 昇
取締役	菊地 豊
取締役	丸山 良次
取締役	田宮 義男
取締役	長谷川 一郎
常勤監査役	手嶋 晴 幾
監査役	檀原 武
監査役	落合 栄

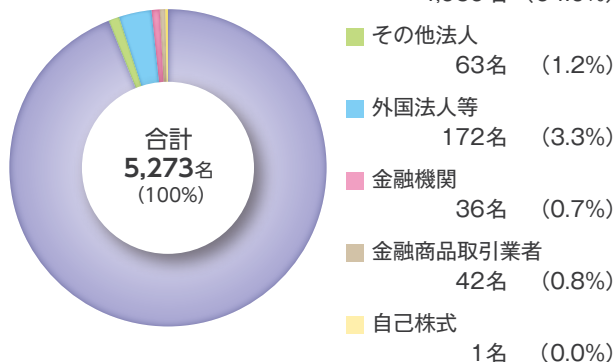
株式情報

発行可能株式総数 62,400,000株
発行済株式総数 20,232,897株
株主数 5,273名
所有者別株式分布状況

所有者別株式数



所有者別株主数



株主メモ/ホームページ紹介

株主メモ

事業年度	4月1日から翌年の3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
株主名簿管理人	東京証券代行株式会社 東京都千代田区大手町二丁目6番2号(日本ビル4階) 取次事務は、三井住友信託銀行株式会社本店および全国各支店で行っております。
郵便物送付先、連絡先	〒168-8522 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 東京証券代行株式会社 事務センター(お問い合わせ先) ☎0120-49-7009
基準日	定時株主総会の議決権 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日
公告方法	電子公告(http://www.enplas.com) ただし、電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載する方法とします。 貸借対照表、損益計算書は、決算公告に代えてEDINET(http://info.edinet-fsa.go.jp/)にて開示しております。
上場金融商品取引所	東京証券取引所 市場第一部

■ホームページトップ画面



エンプラス

検索

■投資家情報画面



エンプラス IR

検索

ホームページ上では会社概要、財務情報をはじめ業務内容やプレスリリースなど最新の情報を幅広くお知らせしています。ぜひご覧ください。

■住所変更・単元未満株式の買取等のお申し出について

お取引口座のある証券会社にお申し出ください。ただし、特別口座に記録された株式に係る各種手続きにつきましては、特別口座の口座管理機関である東京証券代行株式会社にお申し出ください。

■未支払配当金のお支払について

株主名簿管理人である東京証券代行株式会社にお申し出ください。

拠点・グループ会社

技術の絆。信頼の絆。活躍の舞台はグローバルです。

アジア、アメリカ、ヨーロッパにある世界拠点を結ぶグローバルネットワークによって24時間稼働し続ける「エンプラス」グループ。

こうしたグローバルネットワークを通じて、企画・開発段階から、各産業界のトップメーカーと技術に裏打ちされた信頼のパートナーシップを構築。世界企業としてエンプラスは、さらに大きく羽ばたこうとしています。



国内拠点

本社

埼玉県川口市並木2丁目30番1号

鹿沼工場

栃木県鹿沼市さつき町7番2

名古屋営業所

愛知県名古屋市中村区名駅2丁目45番7号
松岡ビル3階

国内グループ会社

株式会社エンプラス研究所

埼玉県川口市並木2丁目38番5号

QMS株式会社

埼玉県川口市上青木1丁目3番12号

■ 西日本営業所

大阪府大阪市淀川区宮原2丁目14番4号
MF新大阪ビル9階

株式会社エンプラス半導体機器

埼玉県川口市上青木1丁目19番57号

■ 九州営業所

福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目2番3号
博多駅前第1ビル2階

株式会社エンプラス ディスプレイ デバイス

埼玉県川口市並木2丁目30番1号

海外グループ会社

Enplas (U.S.A.) , Inc.

1901 West Oak Circle, Marietta, Georgia 30062, U.S.A.

Enplas Tech Solutions. Inc.

1225 Innsbruck Dr., Sunnyvale, CA 94089-1317, U.S.A.

Enplas Hi-Tech (Singapore) Pte. Ltd.

No.28 Genting Lane, #07-03/04/05, Singapore 349585, Republic of Singapore

Enplas Precision (Malaysia) Sdn. Bhd.

No.9&9A Jalan Hasil 2, Kawasan Perindustrian, Jalan Hasil 81200 Johor Bahru, Malaysia

Enplas Precision (Thailand) Co., Ltd.

Hi-Tech Industrial Estate 104 Moo 1, Bhan Lain, Bang Pa-In, Ayutthaya 13160, Thailand

Pinthong Factory (Thailand)

Pinthong Industrial Estate 2 150/30 Moo 9, Tambol Nongkham, Amphur Sriracha, Chonburi 20110, Thailand

Enplas (Vietnam) Co., Ltd.

K-3 Plot, Thang Long Industrial Park, Dong Anh District, Hanoi, Vietnam

Enplas Electronics (Shanghai) Co., Ltd.

Standard Building 85, No.177, Yi Wei Road, Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131, PRC

Guangzhou Enplas Mechatronics Co., Ltd.

Floor1, Standard Building 1, Hexing Industry Park, 10 Yongsheng Road, Yong He Economic Zone, Guangzhou Economic & Technological Development District, Guangzhou City 511356, P.R.C.

Enplas Niching Technology Corporation

4F-1, No.27 Puding Road, Hsinchu City, 300 Taiwan, R.O.C.

Enplas (Hong Kong) Limited

Unit 1506-07A, 15/F, Tower 2, China Hong Kong City, No.33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

PT.Enplas Indonesia

Kawasan Industri Jababeka Tahap 3 Jl. Tekno Boulevard Blok 6 F
Desapasirgombong, Kec. Cikarang Utara, Bekasi 17550, Indonesia

Korea Branch

#710, Hyundai Office Building, 240-3, Hwangsaeul-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-783, Korea

Enplas Semiconductor Peripherals Pte. Ltd.

No.28 Genting Lane, #07-03/04/05, Singapore 349585, Republic of Singapore

株式会社エンプラス

〒332-0034 埼玉県川口市並木2丁目30番1号

Tel : 048-253-3131 (代表) Fax : 048-255-1688

http://www.enplas.com



見やすいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

